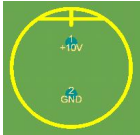


PCB	产品名称	产品型号	版本	页数	制订时间
焊接工艺要求	交流伺服	ISED-F30FX 焊接要求	V8	1	2023-10-9
<p>1. 参照“ISED-F30FX-V8 元件值 PDF”文件；</p> <p>2. 红色序号的元件有焊接高度要求</p> <p style="padding-left: 20px;">D5、D14 的管脚高出线路板 8mm 整，并要横平竖直；</p> <p style="padding-left: 20px;">S1 的管脚高出线路板 7mm 整，并要横平竖直；</p> <p style="padding-left: 20px;">Q2 的管脚高出线路板 7.3mm，并要横平竖直；</p> <p style="padding-left: 20px;">R157、R189、R190 圆体底部高出线路板 2~3mm；</p> <p>3. R1~R4 的位置都是两个 R020/2512 并联，共 8 个电阻；</p> <p>4. U1 焊接时，要完全平行于线路板，模块管脚上有限高；</p> <p>5. FX = F1 时，绿色框内的元件不焊接；</p> <p>6. FX = F2 时，蓝色框内的元件不焊接；</p> <p>7. 打叉的元件，不焊接；红色方框内的元件不焊接；</p> <p>8.  图形中的“+”号，表示是电容的正极，焊接时要注意；</p> <p>9. 未标注的元件，紧贴线路板焊接；</p> <hr/> <p>10. 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准</p>					
编制		审核		批准	
日期		日期		日期	